

先孔工法対応 ポリイミドフィルムへのニッケルシード層形成プロセス

トップSAPINAプロセス

Applicable to Polyimide Film with Hole Nickel Seed Layer Forming Process on Polyimide film

TOP SAPINA PROCESS

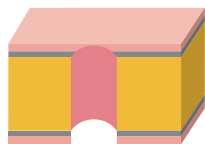
- ▶ 全湿式プロセスであり、Roll to Roll処理により両面を一括でメタライズ可能
- ▶ 金属濃度の低減による低コストを実現
- ▶ パラジウム吸着量の制御による優れたパターン性
- ▶ 先孔工法に対応

- ・ All steps : Wet process
- ・ Metallizing both sides at once by Roll to Roll treatment
- ・ Low metal concentration, effective in cost reduction
- ・ Great fine patterning performance by controlling palladium adsorption amount
- ・ Applicable to polyimide film with hole

処理工程

Process

先孔加工ポリイミド
Polyimide film with hole



表層とホール内を一括でメタライズ可能
Can metalize both sides at once including holes



低いパラジウム濃度

Low palladium concentration

金属濃度が低く、低コストなプロセス

Low metal concentration, cost-effective process

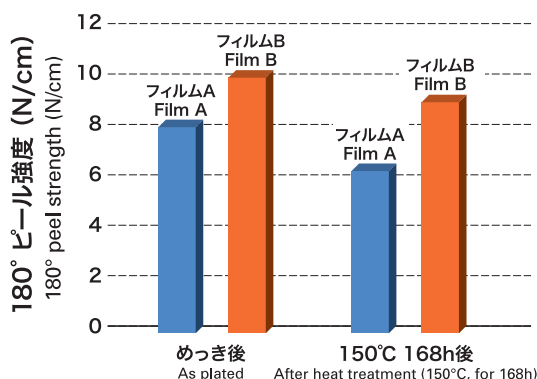
	カタリスト中パラジウム濃度 Palladium concentration in catalyst	パラジウム吸着量 Palladium adsorption amount
トップSAPINAプロセス (アルカリイオンタイプ) TOP SAPINA PROCESS (Alkaline ion type)	105mg/L	17 μ g/dm ²
従来プロセス (酸性コロイドタイプ) Conventional process (Acid colloid type)	190mg/L	30 μ g/dm ²

ピール強度の低下が小さい

Maintain peel strength

密着強度(銅18 μ m)

Adhesion strength (Copper 18 μ m)

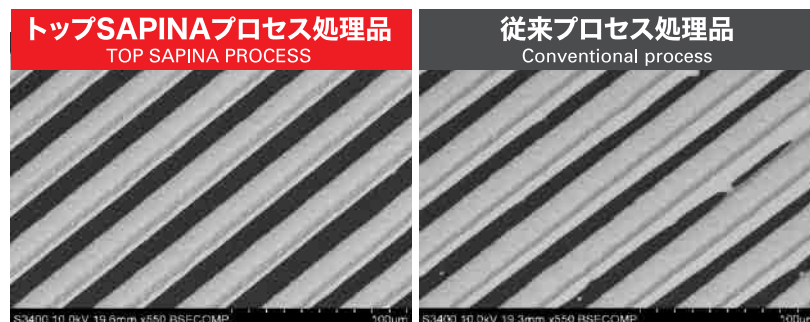


優れたファインパターン性

Excellent in fine patterning performance

パラジウム吸着量が低く、ニッケル/金めっき時のパターン性に優れる

Great fine pattern ability of nickel /gold plating Because of low palladium adsorption amount



L/S=20/20 μ m 無電解ニッケルめっき:3 μ m 置換金めっき:0.05 μ m
Electroless nickel plating: 3 μ m Immersion gold plating: 0.05 μ m